

同志社大学フォーミュラプロジェクト
支援者様

令和4年7月1日

同志社大学フォーミュラプロジェクト
6月活動報告

初夏の候、貴社におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。この度は、同志社大学フォーミュラプロジェクト（以下DUF）の6月の活動についてご報告させていただきます。現在、当プロジェクトではスポンサー企業様・個人支援者様の御支援・御協力により活動を進めており、今年度の大会でより高い成績を獲得するための車両を作り上げるべく、設計製作を行っております。そして、多大なる御支援していただいております企業の皆様、先生方、OBの皆様方に深く感謝いたします。今後とも宜しくお願ひ申し上げます。



図 1. 22project の車両

1. 活動報告

コスト資料提出

6/1(水)にコストレポートを提出しました。今年度も前年度よりも統一事項を増やして、さらに完成度の高い資料となるように心がけました。また今年度は新規部品や再設計を行った部分が多く、製作や確認に時間を費やしてしまいましたが、これで成績が向上することを期待しております。

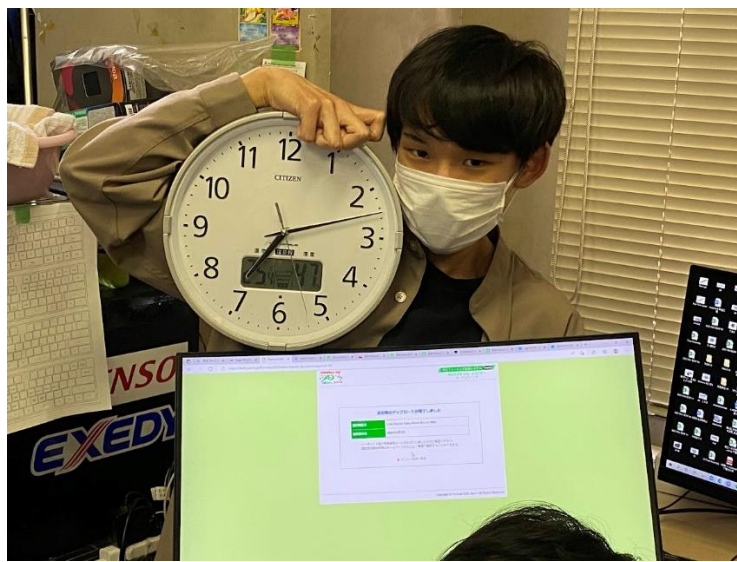


図2. コストレポート提出直後のコスト班長

デザイン資料提出

6/14(火)にデザインレポートを提出しました。今年度より Design Briefing となり、パワーポイントでの資料となりました。今までとは違って、少ない文章と図表でどのようにして相手に伝えるかといったことが重視されており、とても苦労しましたが無事に提出することができてよかったです。



図3. デザインレポートアップロード画面

新入部員への班紹介

6/18(土)に部室にて新入生向けへの班紹介を行いました。

新入生同士は初めて対面した人もおり、班紹介後には楽しそうに話している姿もみられました。これからは例年行っている新歓製作が始まります、この活動を通して新入生の仲と学生フォーミュラへの理解がより深まることを願っています。



図 4. 班紹介の様子

SPD 資料提出

6/20(月)に SPD の提出が完了しました。今大会から【①企業理念】、【②カーボンニュートラルやパンデミックの影響が貴社のビジネスやデザインにどう影響しているか】といった項目が新たに追加されたことで、企業としての存在意義や新しい社会様式への対応策も踏まえて考えなくてはならない、より実践的な審査となりました。

学生フォーミュラ支援システム Team
同志社大学 さん、ようこそ！
カーナンバー：15

提出物のアップロードが完了しました

提出物区分	Sales Presentation Document (pdf/10MB)
提出受付日	2022年6月20日

リーダーとFA宛に受領通知メールをお送りしましたのでご確認ください。
提出物の提出状況はホームページのメニュー画面で確認することができます。

[メニュー画面に戻る](#)

Copyright © Formula SAE Japan All Rights Reserved.

図 5. SPD アップロード画面

エンジンダイナモでの活動

学内のエンジンダイナモにて、エンジン側とダイナモ側のスプロケットをチェーンで繋ぎ、ギアを1速に入れた状態で回転数毎のトルクを測定しました。

今回の活動でしっかりとトルクを測定することができたので、これからは燃調を合わせや、7月の試走会に向けて準備を行いたいと思います。

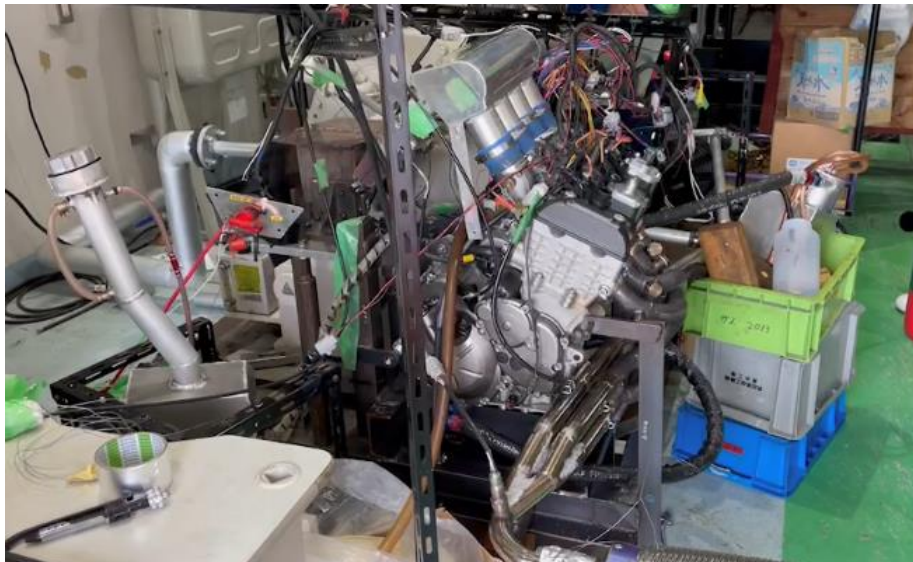
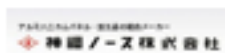


図 6.エンジンダイナモでの活動の様子

2. スポンサー様

スポンサー様一覧



3. 今後の主な活動予定

7/10 自動車練習場試走会

7/17 自動車練習場試走会

7/24 自動車練習場試走会

8/1 泉大津試走会

8/10,8/11 エコパ試走会

4. 最後に

6月は静的資料の作成が主な活動となり、一年間を通して特に忙しい月となりました。各人が協力して資料を作り、意見を言い合うことでチームとしての方向性を改めて決定づけることができたとも感じております。またこれからはいくつかの合同試走会や単独試走会が控えておりますが、昨今は気温も大変高く熱中症の危険性もあるため、水分補給の徹底などを行い、健康に十分配慮し活動を行ってまいります。

昨年度よりさらに高みを目指し、ここからさらに良い車両となるよう鋭意努力しております。今後ともご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

同志社大学フォーミュラプロジェクト (DUFPP)
2022年度プロジェクト総務 野口 創太

〒610-0394

京都府京田辺市多々羅都谷 1-3 同志社大学

URL : <http://dufp.racing>

E-mail : cguf5056@mail4.doshisha.ac.jp
